



2022年3月期 第3四半期決算説明

2022年2月4日



山一電機株式会社

ご説明内容

- 【1】 FY2021 第3四半期業績結果
- 【2】 FY2021 通期予想
- 【3】 配当について

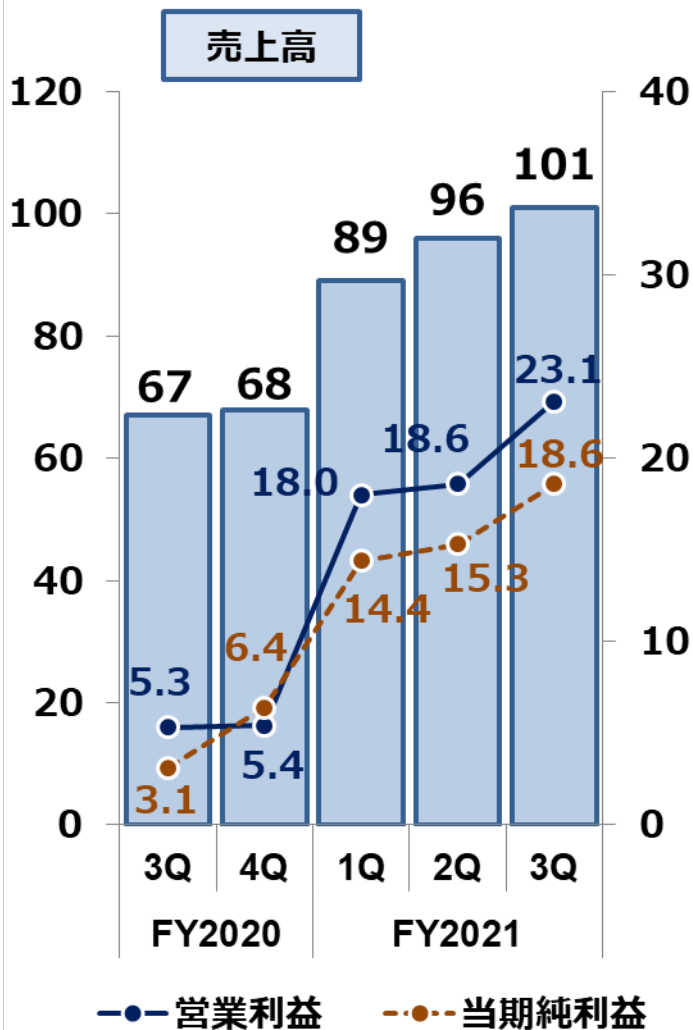
本説明資料内に記載の各事業名の略称について

事業名	事業名略称
テストソリューション事業	TS事業
コネクタソリューション事業	CS事業
光関連事業	OPT事業

FY2021 第3四半期業績結果

単位：億円

好調な半導体市場に牽引され、第3四半期連結累計期間として当社最高営業利益を更新いたしました。



単位：億円	FY2020 3Q実績	FY2021 3Q実績	前年 同期比	前年同期 増減比
売上高	207	287	79	38.1%
営業利益	26.5	59.9	33.4	126.1%
経常利益	25.9	61.6	35.7	138.0%
当期純利益	19.4	48.4	29.0	149.3%
EPS (円)	90.83	228.32	137.49	----
BPS (円)	1130.03	1376.15	246.12	----

為替レート	FY2020/3Q	FY2021/3Q	増減
USD (円)	106.12	111.10	4.98
EUR (円)	122.37	130.61	8.24

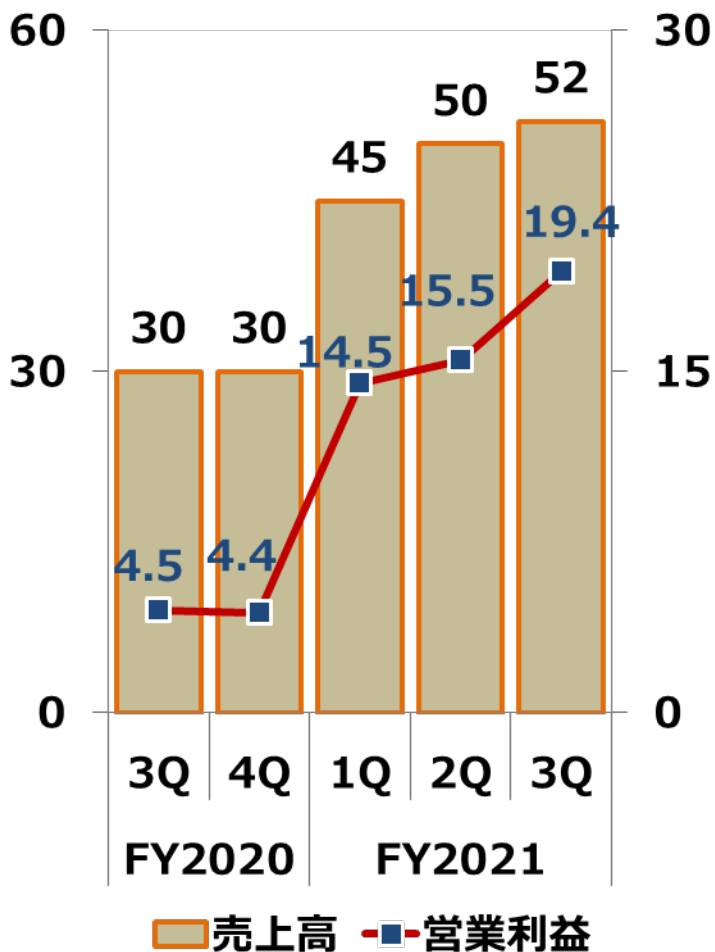
FY2021 第3四半期 事業別業績結果

単位：億円		FY2020 3Q実績	FY2021 3Q実績	前年 同期比	前年同期 増減比
TS事業	売上高	101	148	47	46.6%
	営業利益	21.6	49.6	27.9	129.1%
CS事業	売上高	94	125	31	33.6%
	営業利益	4.1	9.5	5.3	127.4%
OPT事業	売上高	12	12	0	3.0%
	営業利益	0.9	1.8	0.8	93.4%
その他	営業利益 (連結調整額)	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.7	----
合計	売上高	207	287	79	38.1%
	営業利益	26.5	59.9	33.4	126.1%

FY2021 第3四半期 TS事業業績結果

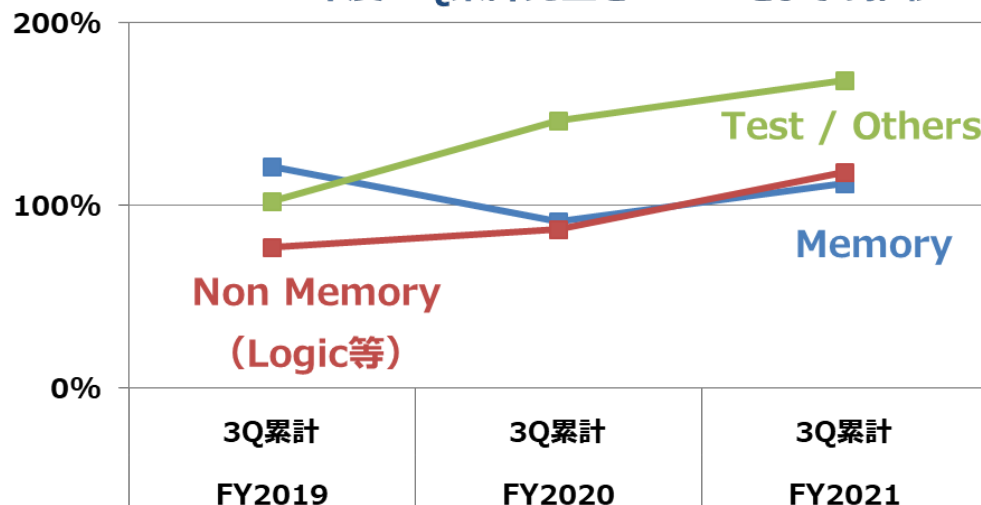
単位：億円 TS事業

TS事業	前年同期比	前年同期増減率
売上高	+47億円	46.6%
営業利益	+27.9億円	129.1%



- ◆ テスト用ソケットはスマートフォン用CPU向け新製品を中心に好調に推移
- ◆ ロジック半導体用ソケットは車載ADAS/MCU向け製品およびPC・サーバー向けも好調に推移
- ◆ メモリ半導体用ソケットはNAND向け新製品の出荷が開始され好調に推移し、DRAM用は低迷が続くなか韓国向けが順調に推移

2018年度3Q累計売上を100%としての推移

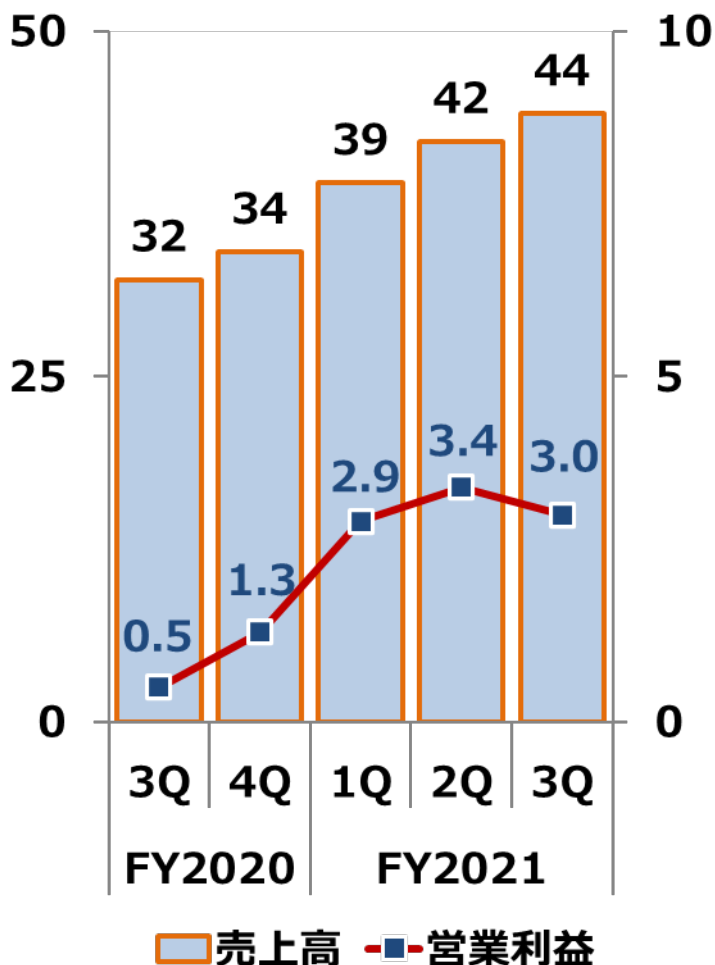


FY2021 第3四半期 CS事業業績結果

CS事業	前年同期比	前年同期増減率
売上高	+31億円	33.6%
営業利益	+5.3億円	127.4%

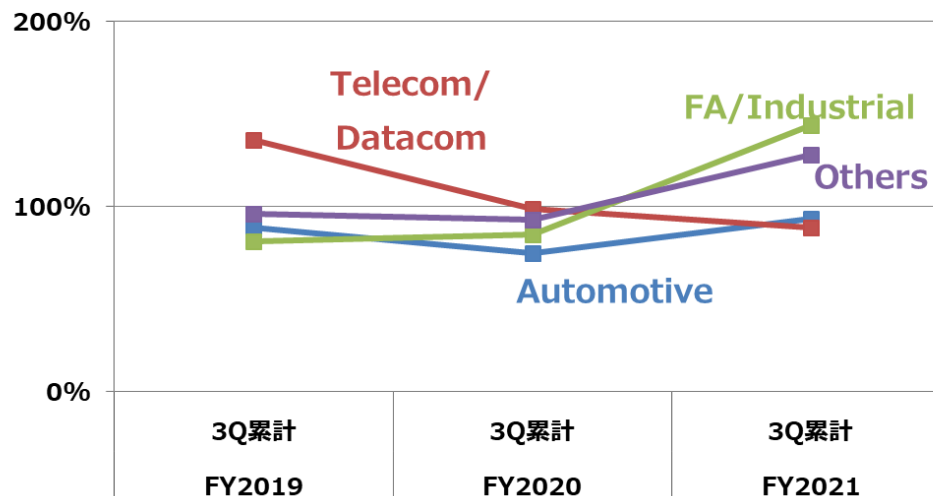
単位：億円

CS事業



- ◆ 車載・産機市場向け製品は需要回復により好調に推移
- ◆ 通信機器向け製品は米中経済摩擦の影響は続いているも、米欧地区を中心に高速大容量伝送の需要拡大を背景に増加に好転
- ◆ 原材料費や輸送費のコストアップで経費が増加したが、生産性ならびに品質改善を行い最小限の影響に留めた

2018年度3Q累計売上を100%としての推移



貸借対照表

単位：億円	2021年 3月末	2021年 12月末	増減額	注記
流動資産	206.4	263.1	56.6	現金及び預金 : 21.4億円増加 売上債権（*） : 20.7億円増加 棚卸資産 : 16.4億円増加
固定資産	148.1	145.5	▲ 2.6	
資産合計	354.6	408.6	54.0	
流動負債	72.4	86.8	14.4	未払法人税等 : 4.5億円増加 仕入債務 : 4.5億円増加 賞与引当金 : 2.8億円増加
固定負債	25.6	27.8	2.2	長期借入金 : 2.9億円増加
負債合計	98.0	114.7	16.6	
純資産合計	256.5	293.8	37.3	
負債純資産合計	354.6	408.6	54.0	

* 売上債権 = 受取手形・売掛金・電子記録債権

FY2021 3Q 為替影響

通貨	2020年度 3Q	2021年度 3Q	増減
USDレート (円)	106.12	111.10	+4.98
EURレート (円)	122.37	130.61	+8.24



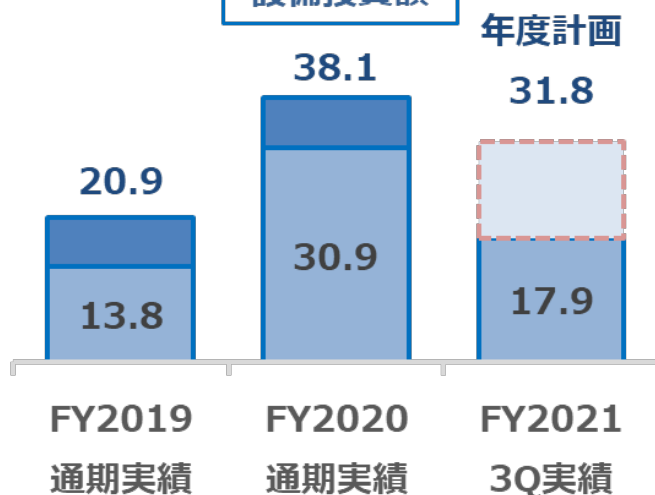
対前年同期為替影響額	
売上高	12.0億円
営業利益	5.8億円

通期の為替感応度 (1円影響額/年間)	売上高影響額	営業利益影響額
USD	2.0億円	1.2億円
EUR	0.7億円	0.1億円

設備投資・減価償却費

単位：億円

設備投資額



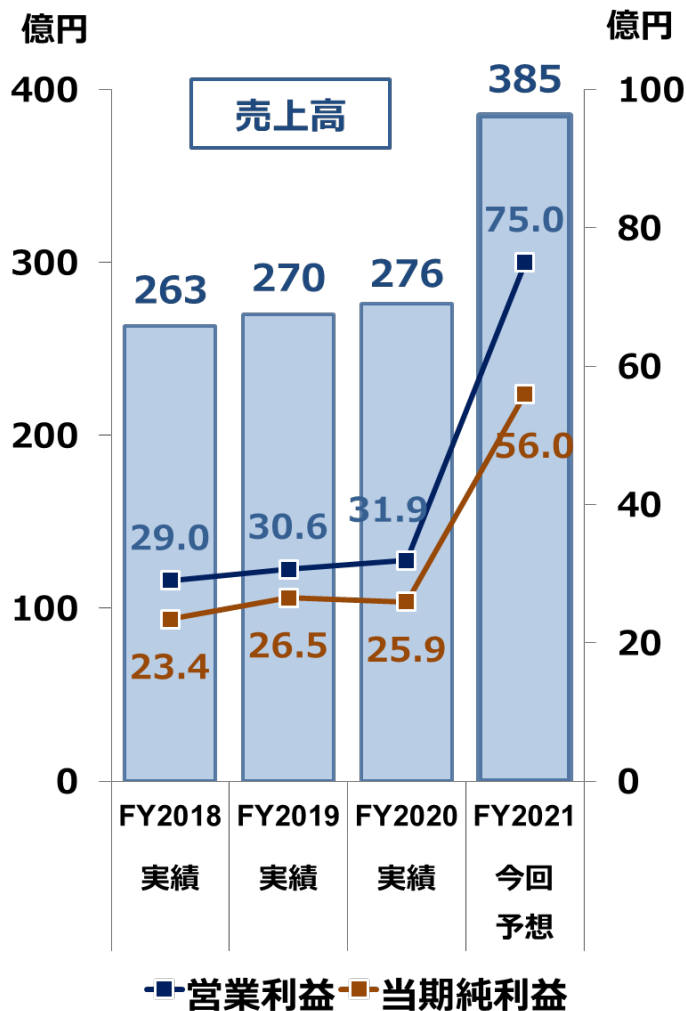
単位：億円

減価償却費



FY2021通期 修正業績予想

24年ぶりの最高営業利益を更新



単位：億円	FY2020 通期実績	FY2021通期			
		11月4日 修正予想	今回予想	対前年 同期比	対前年 同期増減率
売上高	276	360	385	108	39.1%
営業利益	31.9	56.0	75.0	43.0	134.9%
経常利益	31.4	57.0	77.0	45.5	144.9%
当期純利益	25.9	44.0	56.0	30.0	116.0%
EPS (円)	121.10	207.46	264.04	142.94	----

2021年度連結業績予想の前提となる為替レート

為替レート	FY2020	FY2021	増減
USD (円)	106.06	112.00	5.94
EUR (円)	123.70	130.00	6.30

FY2021通期 事業別修正業績予想

単位：億円		FY2020 通期実績	FY2021通期		対前年 同期比	対前年 同期増減率
			11月4日 修正予想	今回予想		
TS事業	売上高	131	184	200	68	51.8%
	営業利益	26.1	46.5	62.0	35.8	137.2%
CS事業	売上高	128	160	168	39	30.5%
	営業利益	5.4	8.5	12.0	6.5	118.7%
OPT事業	売上高	16	16	17	0	4.4%
	営業利益	1.0	1.6	2.2	1.1	111.8%
その他	営業利益 (連結調整額)	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.4	----
合計	売上高	276	360	385	108	39.1%
	営業利益	31.9	56.0	75.0	43.0	134.9%

FY2021通期 事業別業績予想

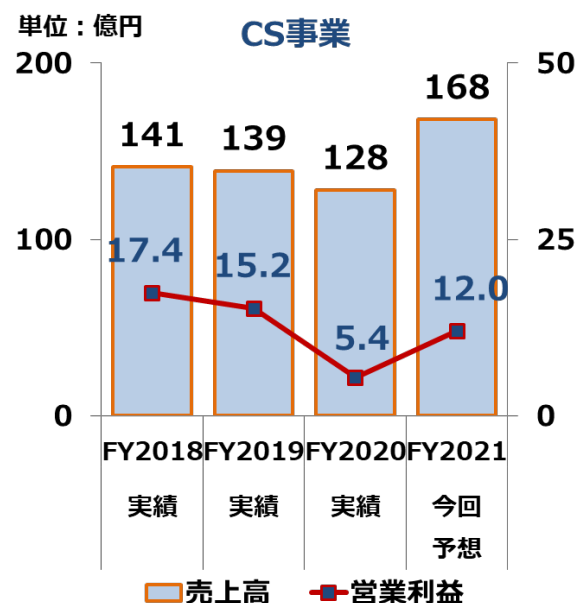
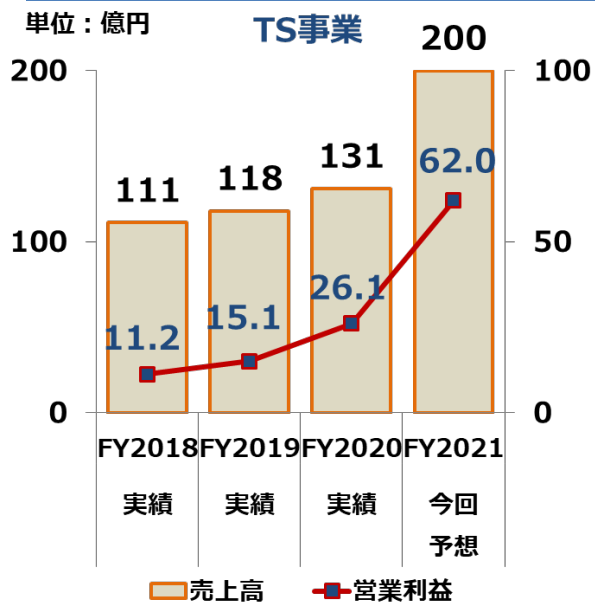
当社グループの関連する電子部品業界では、スマートフォンや携帯機器の高機能化とデータセンタの能力増強に伴う各種半導体や電子部品、走行安全・自動運転等自動車の更なる高機能化に向けた車載用半導体や各種電子部品の需要が拡大しております。

TS事業：

- ◆ テストソケットはスマートフォン向けを中心に期を通して例年以上の推移を見込む
- ◆ メモリ半導体用ソケットは新製品出荷が開始され順調な推移を見込む
- ◆ ロジック半導体用ソケットは車載ADAS/MCU向けを中心に順調な推移が続くと共に、PC・サーバー用が堅調な推移を見込む

CS事業：

- ◆ 産機市場向け製品は需要回復基調が続く見込み
- ◆ 車載市場向け製品は半導体不足に伴う減産調整の影響があるものの堅調な推移を見込む
- ◆ 通信市場向けは米中経済摩擦の影響は残るものの、米欧地域での需要拡大を見込む
- ◆ 原材料費や輸送費のコストアップによる影響が見込まれるが、継続して影響を最小限に留めるべく活動を進める



【3】配当について

2021年度 配当金について

- ◆ 当社グループは、先の中期経営計画で配当性向30%を目指すことを公表し、2018年度より継続して30%を維持しております。本年度も通期の業績予想修正に伴い、期末配当予想額を、配当性向30%を基準に円といたします。
ただし、最終配当金額については、2022年3月期 期末決算時の純利益額にて調整させていただきます。

	年間配当金		
	第2四半期末	期末	合計
前回予想 (2021年11月5日公表)	15円	48円	63円
今回公表予想	15円	65円	80円
(ご参考) 前期実績 (2021年3月期)	10円	27円	37円

- ◆ 2022年3月期の期末配当につきましては、2022年6月に開催予定の定時株主総会に付議する予定であります。

ご清聴ありがとうございました

(期末決算発表日 2022年5月13日(金) 15:00予定)

※注意事項

本資料は、2022年2月4日現在の当社グループの事業内容、経営戦略、業績に関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券への投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料に記載した意見や予測等は資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更する場合があります。

問合せ先：経営管理部広報課 古畑 利之

TEL：03-3734-7661 FAX: 03-3734-0120

<http://www.yamaichi.co.jp>

E-mail: furuhata@yamaichi.co.jp